

# IR 事業説明会

戦略本部長  
牧 謙

2018年6月8日  
古河電気工業株式会社

## 将来情報についての注意事項

この資料に記載されております売上高及び利益等の計画のうち、過去または現在の事実に関するもの以外は、当社グループの各事業に関する業界の動向についての見通しを含む経済状況、ならびに為替レートの変動その他の業績に影響を与える要因について、現時点で入手可能な情報をもとにした当社グループの仮定及び判断に基づく見通しを前提としております。

これら将来予想に関する記述は、既知または未知のリスク及び不確実性が内在しており、例として以下のものが挙げられますが、これらに限られるものではありません。

- ・米国、欧州、日本その他のアジア諸国の経済情勢、特に個人消費及び企業による設備投資の動向
- ・米ドル、ユーロ、アジア諸国の各通貨の為替相場の変動
- ・急速な技術革新と当社グループの対応能力
- ・財務的、経営的、環境的な諸前提の変動
- ・諸外国による現在及び将来の貿易規制等
- ・当社グループが所有する有価証券等の時価の変動

従いまして、実際の売上高及び利益等と、この資料に記載されております計画とは大きく異なる場合があることをご承知おき下さい。なお、当社グループは、この資料の本リリース後においても、将来予想に関する記述を更新して公表する義務を負うものではありません。

## 著作権等について

この資料のいかなる部分についてもその著作権その他一切の権利は、古河電気工業株式会社に帰属しており、あらゆる方法を問わず、無断で複製または転用することを禁止します。

古河電気工業株式会社

## I. 中長期営業利益予想と

### 事業セグメントにおける主な利益成長のポイント

## II. 事業資産営業利益率によるマネジメント強化

## III. 機能製品事業の成長戦略

# 利益成長を支える15事業部門

	事業部門	
情報通信ソリューション統括部門	<p>ファイバ・ケーブル</p> <p>ファイテル</p>	<p>ブロードバンドソリューション</p>
エネルギーインフラ統括部門	<p>電力</p>	<p>産業電線・機器</p>
電装エレクトロニクス統括部門 自動車部品・電池 電装エレクトロニクス材料	<p>自動車部品</p> <p>古河電池(株)</p>	<p>導電材</p> <p>銅条・高機能材</p> <p>巻線</p> <p>銅管</p>
機能製品	<p>AT・機能樹脂</p> <p>メモリーディスク</p>	<p>サーマル・電子部品</p> <p>銅箔</p>

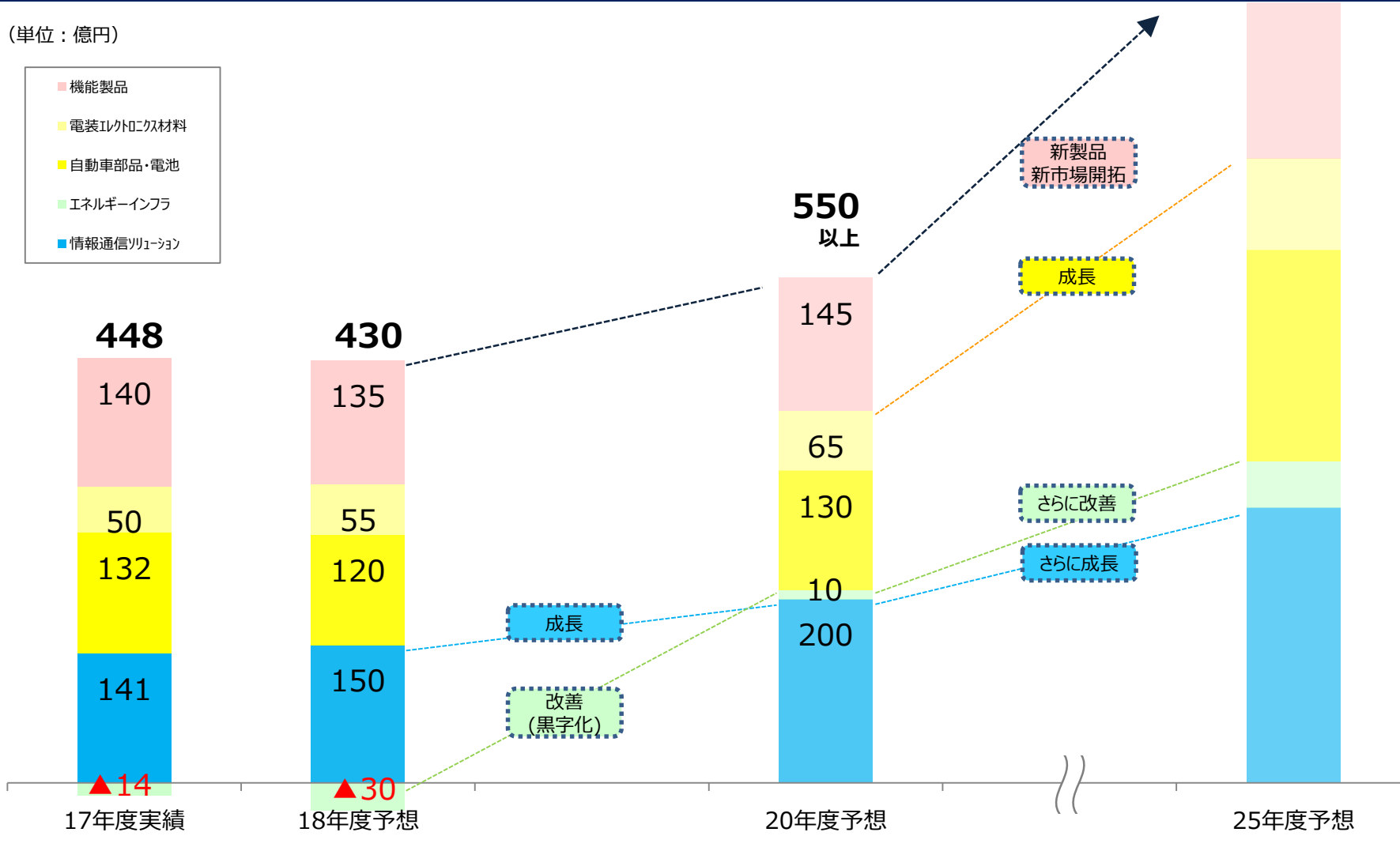
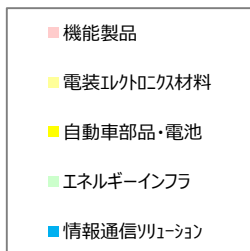
# I. 事業セグメントにおける主な利益成長のポイント FURUKAWA ELECTRIC

セグメント	サブセグメント	主な収益成長のポイント
インフラ	情報通信ソリューション	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ファイバ・ケーブル投資効果（19年度より発現）</li> <li>・光部品の収益回復</li> <li>・ソリューション事業の強化</li> </ul>
	エネルギーインフラ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・海底線・地中線受注による投資効果</li> <li>・建設・電販用差別化製品投入</li> </ul>
電装エレクトロニクス	自動車部品・電池	<ul style="list-style-type: none"> <li>・軽量化要望に応えるハーネス拡大による投資効果</li> <li>・高機能BSS、次世代レーダなどの投入</li> </ul>
	電装エレクトロニクス材料	<ul style="list-style-type: none"> <li>・車の電動化に伴う巻線事業の拡大</li> <li>・製品ミックス最適化による銅条改善</li> </ul>
機能製品		<ul style="list-style-type: none"> <li>・データセンター向け商材の強化</li> <li>・新製品導入、新市場開拓</li> </ul>

# I. 中長期営業利益予想

20年度までの収益牽引事業は、情報通信の成長とエネルギーインフラの改善が主  
自動車関連事業と新市場開拓・新製品による機能製品拡大が加わり、中長期で収益成長は継続

(単位：億円)



## 全事業部門で事業資産利益率を意識したKPI管理を徹底

KGI-KSF-KPIツリー 18年度

SBU名

銅条・高機能材事業部門

①全体業績<KGI>

②セグメント情報<KGI>

<重点施策>

③取り組み指標<KPI>

ROE

- <主なKSF>
- ・ 安定した製造能力確保
  - ・ 製品ポートフォリオ最適化
  - ・ 売上高向上
  - ・ IT競争力向上
  - ・ 顧客対応力向上

ROIC代替

事業資産  
営業利益率

営業利益

事業資産

固定資産

棚卸資産

営業利益

当期利益

カバレッジ

レバレッジ

有利子負債

自己資本

単体  
営業利益

古河精密  
営業利益

FPT  
営業利益

FTM  
営業利益



## 全事業部門で事業資産利益率を意識したKPI管理を徹底

KGI-KSF-KPIツリー 18年度

SBU名

銅条・高機能材事業部門

①全体業績<KGI>

②セグメント情報<KGI>

<重点施策>

③取り組み指標<KPI>

ROE

- <主なKSF>
- ・安定した製造能力確保
  - ・製品ポートフォリオ最適化
  - ・売上高向上
  - ・コスト競争力向上
  - ・顧客対応力向上

ROIC代替

事業資産  
営業利益率

営業利益

事業資産

固定資産

棚卸資産

営業利益

当期利益

カバレッジ

レバレッジ

有利子負債

自己資本

単体  
営業利益

古河精密  
営業利益

FPT  
営業利益

FTM  
営業利益

重点施策とKPI (抜粋) \* 銅条・高機能材事業部門

<重点施策>

- ・ものづくり力改善
- ・製品ミックス最適化の実行

<KPI>

- ・製造歩留り
- ・低採算品の縮小・値上げ状況
- ・ターゲット市場に向けた重点商品拡販に伴う利益額

KPIの進捗・課題と対応策について  
月次で報告を実施



## 事業部門でのKPIフォロー月次報告（イメージ）

### 全体業績

	予想	実績	達成率
売上高	XXX	XXX	XX%
営業利益	XXX	XXX	XX%
当期純利益	XXX	XXX	XX%
有利子負債残高	XXX	XXX	XX%
棚卸残高・日数	XXX	XXX	XX%

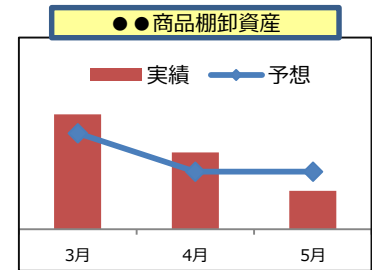
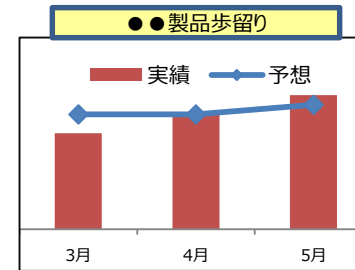
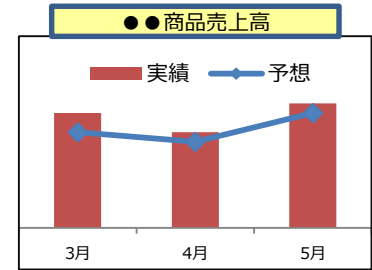
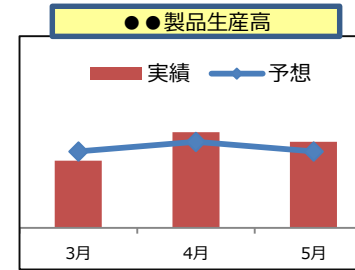
### セグメント（事業・製品別等）業績

	予想	実績	達成率
A事業	XXX	XXX	XX%
B事業	XXX	XXX	XX%
C事業	XXX	XXX	XX%
・	XXX	XXX	XX%
・	XXX	XXX	XX%

### 課題と対策

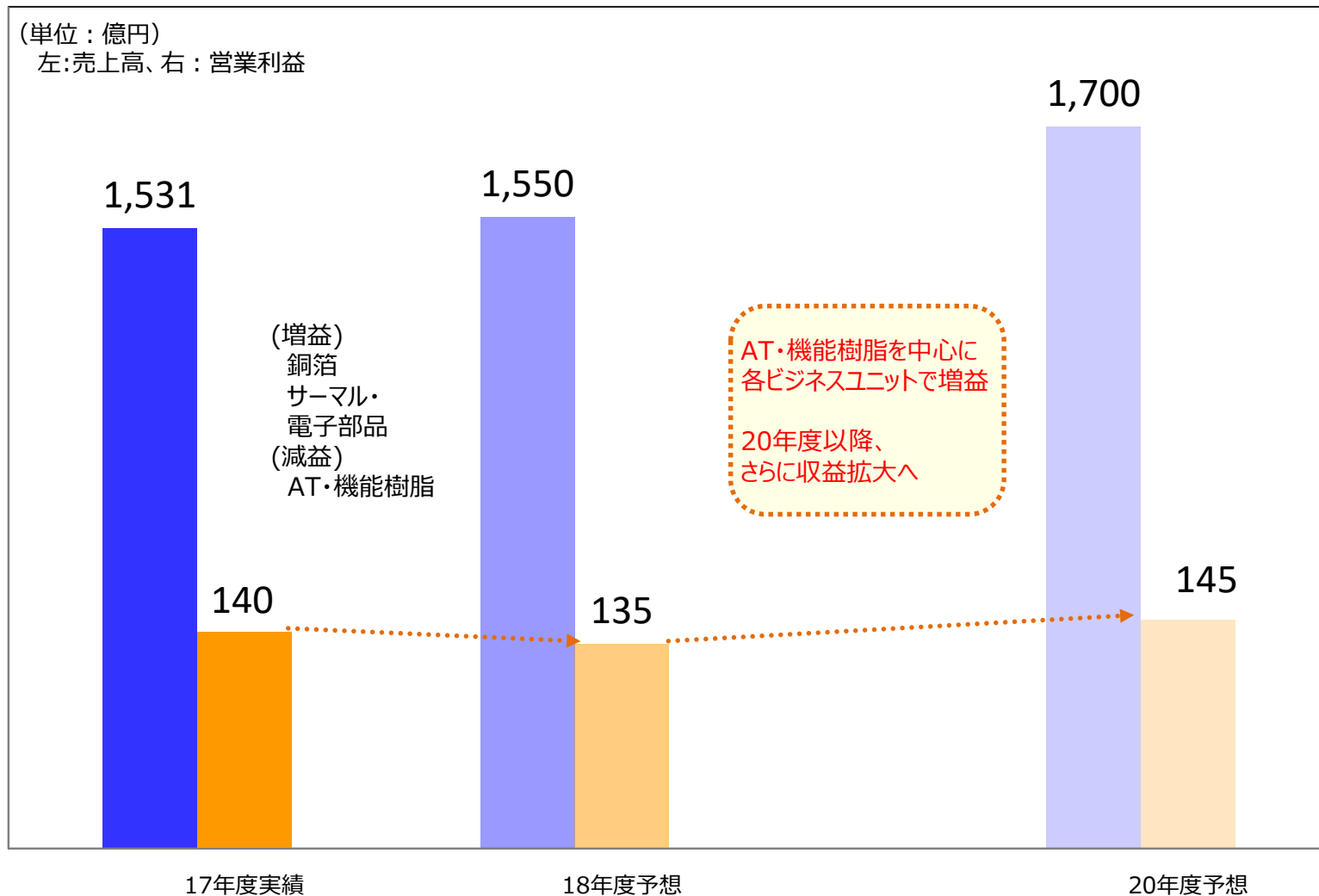
上記より課題	未達要因	対応策
B事業	XXX	XXX
C事業	XXX	XXX
D事業	XXX	XXX

### KPI管理



目標		評価
戦略商品 ●●拡販	XXX	☀️
●●開発	XXX	☁️
●●原価低減	XXX	☀️
●●製造 歩留り改善	XXX	☔️

## 収益性を維持しながら、次の成長にむけた新製品開発・用途展開を推進

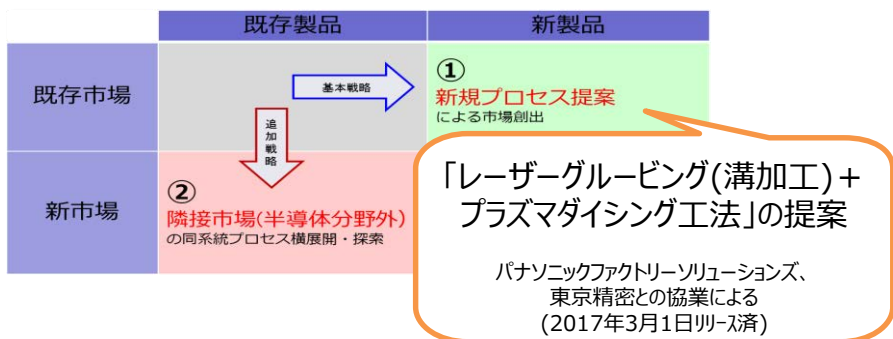


## 次の成長にむけた新製品開発・用途展開を推進

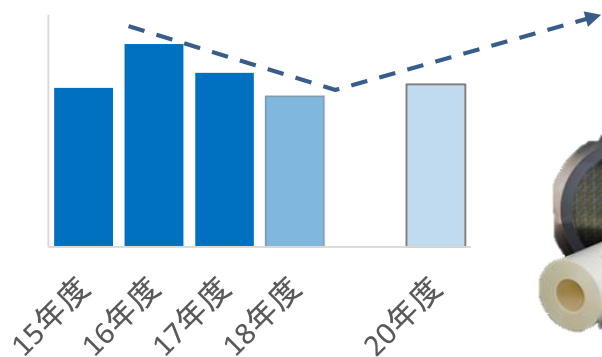
### A T・機能樹脂

#### 半導体製造用テープ

- 顧客の「最適な製造プロセス」実現のための提案
- 半導体製造用以外の用途展開も推進中



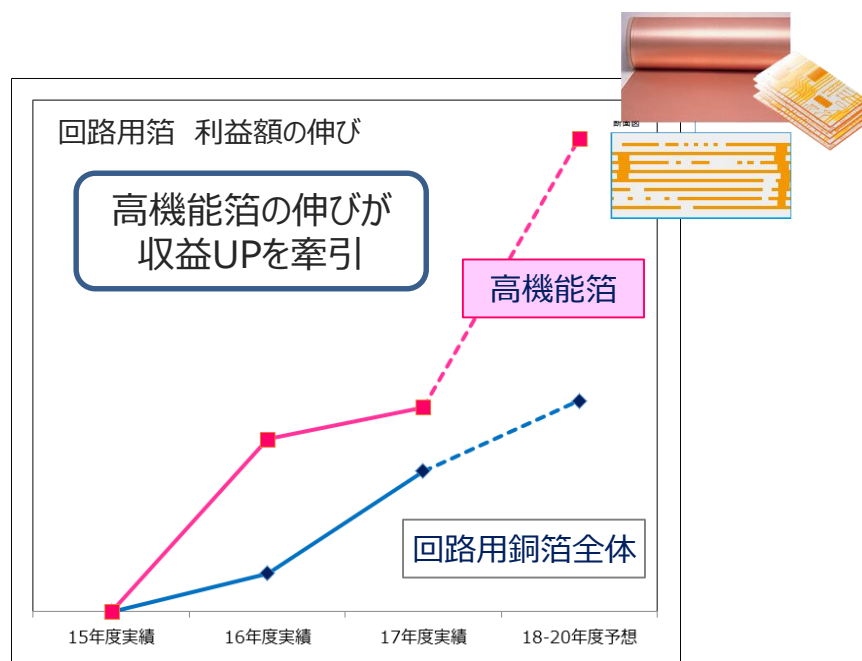
半導体製造用テープ売上高



## 当社電解銅箔の特長を生かし、高付加価値製品にシフト

### 銅箔

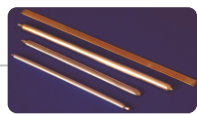
- ✓ 情報通信データの「高速大容量化に貢献する」高機能箔に注力
- ✓ 電池用箔は、EVのほかパワーツール系にも注力



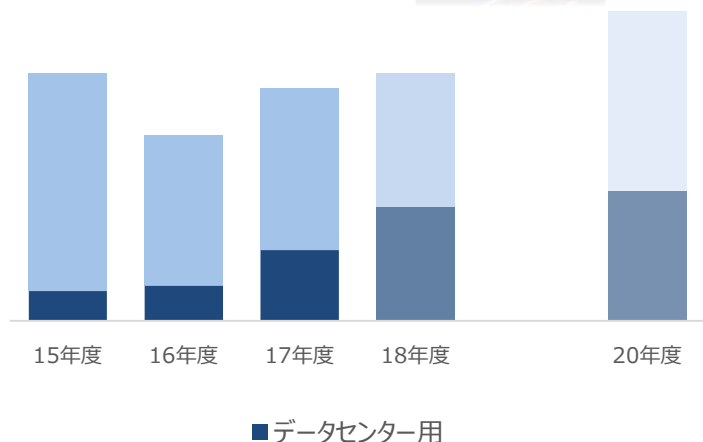
## データセンター、サーバ用中心に事業成長を確保、新製品開発・用途展開も推進中

### サーマル・電子部品

- ✓ データセンター分野におけるトップサプライヤとしての地位確立を目指す
- ✓ 時代の変化に伴い発生する熱問題に対するソリューション提案推進中



売上高推移

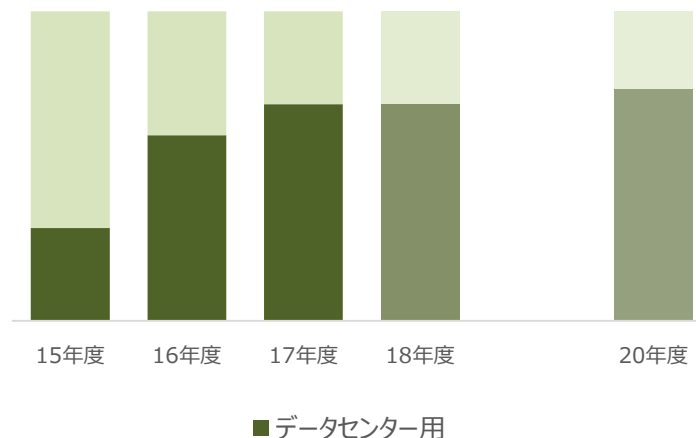


### メモリーディスク

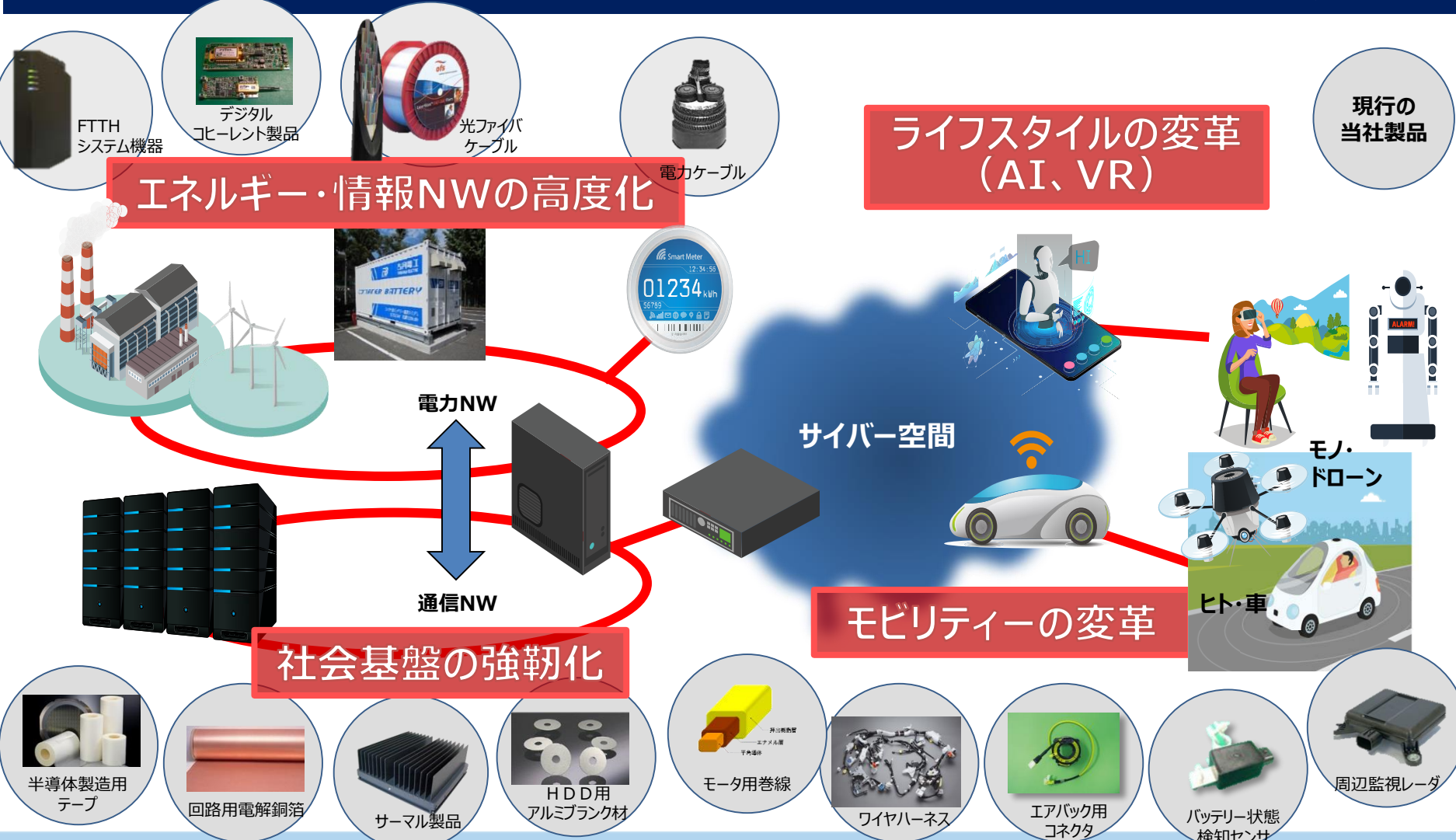
- ✓ データセンター向けHDD用の薄板アルミブランク材が利益のけん引役
- ✓ 今後もHDDの高容量化ニーズに対応



売上高に占めるデータセンター用構成比



エネルギー・情報・熱を、伝える・繋ぐ・蓄えることで、  
インフラ・自動車部品とその融合分野を中心とした社会変化に貢献してまいります



ご清聴ありがとうございました。

***Bound to***  ***Innovate***

# <参考> 機能製品セグメント - 概要

事業	主要製品	用途	現状
A T ・ 機能樹脂	<ul style="list-style-type: none"> <li>半導体製造用テープ</li> </ul>  <p>AT : Advanced Technology Tape</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>半導体ウエハの加工工程での、表面保護や固定など</li> <li>フラッシュメモリー内での半導体チップ積層</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>海外売上比率 9割</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ケーブル保護管</li> <li>断熱材</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>地中埋設ケーブルの保護管</li> <li>空調配管用断熱材</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>国内シェア5割強 (ケーブル保護管)</li> <li>国内シェア5割弱 (空調配管用断熱材)</li> </ul>
銅箔	<ul style="list-style-type: none"> <li>回路用 電解銅箔</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>リジッド基板</li> <li>F P C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>高付加価値製品にシフト</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>電池用 電解銅箔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>車載リチウムイオン電池の負極材</li> <li>スマートフォン、パワーツールなど、民生用リチウムイオン電池の負極材</li> </ul>	
サ ー マ ル 電 子	<ul style="list-style-type: none"> <li>銅等のヒートシンク、ヒートパイプ</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>CPUやパワー半導体、電子部品、高出力LED照明などの放熱・冷却</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>売上構成比</li> <li>FY16→FY17→FY18</li> <li>PC 5割→4割→3割</li> <li>データセンタ 2割→3割→4割</li> </ul>
デ ィ モ リ ス ク ィ	<ul style="list-style-type: none"> <li>HDD用 アルミブランク材</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>PCやデータセンタのHDD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>世界シェア 4割</li> <li>売上構成比</li> <li>PC 4割, データセンタ 6割</li> </ul>

※その他：東京特殊電線、F C M、販社 など